# 表贴低通滤波器 · DC–65 MHz

采用 50 Ω 表贴结构。布板前请结合 18.8 × 11.18 × 6.86 mm 封装尺寸核对焊盘布局。

## 射频性能

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 通带 | DC–65 MHz |
| 通带插入损耗 [1] | ≤1.0 dB |
| 阻带抑制 [2] | ≥20 dB |
| 阻带抑制 [3] | ≥40 dB |
| 电压驻波比 [1] | 1.3:1 (典型) |
| –3 dB 频率 | 71 MHz |

[1] DC–65 MHz
[2] 86–96 MHz
[3] 96–710 MHz

## 设计额定值 设计保证

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 承受功率 | 0.5 W |
| 工作温度 | –40…+85 °C |
| 储存温度 | –55…+100 °C |

## 典型实测响应

| 频率 (MHz) | S11 电压驻波比 | S22 电压驻波比 | S12 损耗（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 1.08 | 1.24 | -0.01 |
| 6 | 1.04 | 1.03 | -0.13 |
| 13 | 1.04 | 1.05 | -0.19 |
| 19 | 1.08 | 1.09 | -0.26 |
| 26 | 1.17 | 1.17 | -0.44 |
| 32 | 1.2 | 1.22 | -0.56 |
| 39 | 1.14 | 1.16 | -0.47 |
| 45 | 1.07 | 1.03 | -0.52 |
| 51 | 1.12 | 1.12 | -0.63 |
| 58 | 1.05 | 1.1 | -0.78 |
| 64 | 1.21 | 1.17 | -0.78 |

## 典型实测响应

| 频率 (MHz) | S11 电压驻波比 | S22 电压驻波比 | S12 损耗（dB） |
|---|---|---|---|
| 71 | 2.34 | 2.23 | -4.31 |
| 77 | 28.16 | 33.08 | -12.01 |
| 84 | 23.5 | 24.66 | -23.15 |
| 90 | 435.58 | 188.49 | -32.51 |

## 机械规格

| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 封装尺寸 | 18.8 ±0.2 × 11.18 ±0.2 × 6.86 ±0.2 mm |
| 射频阻抗 | 50 Ω |
| 安装形式 | 表面贴装 |
| 射频端子 | 1, 8 |
| 接地引脚 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 单个焊盘尺寸 | 1.52 × 1.4 mm |
| 同排相邻焊盘中心距 | 5.08 mm |
| 焊盘阵列外缘间尺寸 | 16.76 × 11.94 mm |

## PCB 装配

清洗产品表面时，不得将滤波器浸入清洗液。 支持 190 °C 回流焊。 PCB 焊盘为两排，每排四个。从器件底面观察，以 1 号端子处于左上角为准，上排依次为 1、3、5、7 号，下排依次为 2、4、6、8 号。1 号和 8 号用于射频输入或输出，2 至 7 号接地。 按底视方向，1 号端子缺口宽 1.52 mm，自上缘向内深 1.02 mm。2 号与 4 号端子的中心距为 5.08 mm，2 号端子中心距左缘 1.78 mm。8 号端子的金属化区域自右缘向内 3.54 mm、自下缘向内 2.22 mm。

**文档说明**

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。